

DSC-W150/W170

SERVICE MANUAL

LEVEL 3

Ver. 1.2 2009.06

Revision History

**Internal memory
ON BOARD**

Revised-1

Replacement of the previously issued
SERVICE MANUAL 9-852-296-12
with this manual.



Photo: DSC-W150/Silver

*US Model
Canadian Model
AEP Model
UK Model
E Model
Australian Model
Hong Kong Model
Chinese Model
Korea Model
Argentine Model
Brazilian Model
Thai Model
Japanese Model
Tourist Model*

Link

• **MODEL INFORMATION TABLE**

• **SCHEMATIC DIAGRAMS**

• **REPAIR PARTS LIST**

• **SERVICE NOTE**

• **PRINTED WIRING BOARDS**

The components identified by
mark $\triangle$ or dotted line with
mark $\triangle$ are critical for safety.
Replace only with part num-
ber specified.

Les composants identifiés par une
marque $\triangle$ sont critiques pour la
sécurité.
Ne les remplacer que par une pièce
portant le numéro spécifié.

DIGITAL STILL CAMERA

SONY®

Ver. 1.1 2008.05

The changed portions from
Ver. 1.0 are shown in blue.

Model information table

Model	DSC-W150	DSC-W170
Destination	US, CND, AEP, UK, E, AUS, HK, CH, KR, AR, BR, TH , JE	US, CND, AEP, UK, E, AUS, HK, CH, KR, AR, BR, TH , J
CD board	CD-732	CD-733

- Abbreviation
 - AR : Argentine model
 - AUS : Australian model
 - BR : Brazilian model
 - CH : Chinese model
 - CND : Canadian model
 - EE : East European model
 - HK : Hong Kong model
 - J : Japanese model
 - JE : Tourist model
 - KR : Korea model
 - NE : North European model
 - [TH](#) : [Thai model](#)

CAUTION

Danger of explosion if battery is incorrectly replaced.
Replace only with the same or equivalent type.

SAFETY-RELATED COMPONENT WARNING!!

COMPONENTS IDENTIFIED BY MARK $\triangle$ OR DOTTED LINE WITH MARK $\triangle$ ON THE SCHEMATIC DIAGRAMS AND IN THE PARTS LIST ARE CRITICAL TO SAFE OPERATION. REPLACE THESE COMPONENTS WITH SONY PARTS WHOSE PART NUMBERS APPEAR AS SHOWN IN THIS MANUAL OR IN SUPPLEMENTS PUBLISHED BY SONY.

**ATTENTION AU COMPOSANT AYANT RAPPORT
À LA SÉCURITÉ!**

LES COMPOSANTS IDENTIFIÉS PAR UNE MARQUE $\triangle$ SUR LES DIAGRAMMES SCHÉMATIQUES ET LA LISTE DES PIÈCES SONT CRITIQUES POUR LA SÉCURITÉ DE FONCTIONNEMENT. NE REMPLACER CES COMPOSANTS QUE PAR DES PIÈCES SONY DONT LES NUMÉROS SONT DONNÉS DANS CE MANUEL OU DANS LES SUPPLÉMENTS PUBLIÉS PAR SONY.

SAFETY CHECK-OUT

After correcting the original service problem, perform the following safety checks before releasing the set to the customer.

1. Check the area of your repair for unsoldered or poorly-soldered connections. Check the entire board surface for solder splashes and bridges.
2. Check the interboard wiring to ensure that no wires are "pinched" or contact high-wattage resistors.
3. Look for unauthorized replacement parts, particularly transistors, that were installed during a previous repair. Point them out to the customer and recommend their replacement.
4. Look for parts which, through functioning, show obvious signs of deterioration. Point them out to the customer and recommend their replacement.
5. Check the B+ voltage to see it is at the values specified.
6. Flexible Circuit Board Repairing
 - Keep the temperature of the soldering iron around 270°C during repairing.
 - Do not touch the soldering iron on the same conductor of the circuit board (within 3 times).
 - Be careful not to apply force on the conductor when soldering or unsoldering.

Unleaded solder

Boards requiring use of unleaded solder are printed with the lead-free mark (LF) indicating the solder contains no lead.

(Caution: Some printed circuit boards may not come printed with the lead free mark due to their particular size.)

**: LEAD FREE MARK**

Unleaded solder has the following characteristics.

- Unleaded solder melts at a temperature about 40°C higher than ordinary solder.

Ordinary soldering irons can be used but the iron tip has to be applied to the solder joint for a slightly longer time.

Soldering irons using a temperature regulator should be set to about 350°C.

Caution: The printed pattern (copper foil) may peel away if the heated tip is applied for too long, so be careful!

- Strong viscosity

Unleaded solder is more viscous (sticky, less prone to flow) than ordinary solder so use caution not to let solder bridges occur such as on IC pins, etc.

- Usable with ordinary solder

It is best to use only unleaded solder but unleaded solder may also be added to ordinary solder.

注意

電池の交換は、正しく行わないと破裂する恐れがあります。電池を交換する場合には必ず同じ型名の電池又は同等品と交換してください。

サービス、点検時には次のことにご注意下さい。

1. 注意事項をお守りください。

サービスのとき特に注意を要する個所については、キャビネット、シャーシ、部品などにラベルや捺印で注意事項を表示しています。これらの注意書き及び取扱説明書等の注意事項を必ずお守り下さい。

2. 指定部品のご使用を

セットの部品は難燃性や耐電圧など安全上の特性を持ったものとなっています。従って交換部品は、使用されていたものと同じ特性の部品を使用して下さい。特に回路図、部品表に△印で指定されている安全上重要な部品は必ず指定のものをご使用下さい。

3. 部品の取付けや配線の引きまわしはもとどおりに

安全上、チューブやテープなどの絶縁材料を使用したり、プリント基板から浮かして取付けた部品があります。また内部配線は引きまわしやクランパによって発熱部品や高圧部品に接近しないよう配慮されていますので、これらは必ずもとどおりにして下さい。

4. サービス後は安全点検を

サービスのために取外したネジ、部品、配線がもとどおりにになっているか、またサービスした個所の周辺を劣化させてしまったところがないかななどを点検し、安全性が確保されていることを確認して下さい。

5. チップ部品交換時の注意

- 取外した部品は再使用しないで下さい。
- タンタルコンデンサのマイナス側は熱に弱いため交換時は注意して下さい。

6. フレキシブルプリント基板の取扱いについて

- コテ先温度を270℃前後にして行なって下さい。
- 同一パターンに何度もコテ先を当てないで下さい。
(3回以内)
- パターンに力が加わらないよう注意して下さい。

7. 無鉛半田について

無鉛半田を使用している基板には、無鉛 (Lead Free) を意味するレッドフリーマークがプリントされています。

(注意：基板サイズによっては、無鉛半田を使用してもレッドフリーマークがプリントされていないものがあります)

：レッドフリーマーク

無鉛半田には、以下の特性があります。

- 融点が従来の半田よりも約40℃高い。
従来の半田こてをそのまま使用することは可能ですが、少し長めにこてを当てる必要があります。
温度調節機能のついた半田こてを使用する場合、約350℃に設定して下さい。
注意：半田こてを長く当てすぎると、基板のパターン (銅箔) がはがれてしまうことがありますので、注意して下さい。
- 粘性が強い
従来の半田よりも粘性が強いため、IC端子などが半田ブリッジしないように注意して下さい。
- 従来の半田と混ぜて使用可能
無鉛半田には無鉛半田を追加するのが最適ですが、従来の半田を追加しても構いません。

1-4. METHOD FOR COPYING OR ERASING THE DATA IN INTERNAL MEMORY

The data can be copied/erased by the operations on the HOME screen. (When erasing the data, execute formatting the internal memory.)

Note 1: When replacing the SY-194 board, erase the data in internal memory of the board before replacement.

Note 2: When replacing the SY-194 board, execute formatting and initialize the internal memory after replacement.

Method for Copying the Data in Internal Memory

Copy

Copies all images in the internal memory to a "Memory Stick Duo".

- ① Insert a "Memory Stick Duo" having sufficient free capacity.
- ② Select [Copy] with ▲/▼ on the control button, then press ●.
The message "All data on internal memory will be copied" appears.
- ③ Select [OK] with ▲, then press ●.
Copying starts.

To cancel copying

Select [Cancel] in step ③, then press ●.

- Use a fully charged battery pack. If you attempt to copy image files using a battery pack with little remaining charge, the battery pack may run out, causing copying to fail or possibly corrupting the data.
- You cannot select images to copy.
- The original images in the internal memory are retained even after copying. To delete the contents of the internal memory, remove the "Memory Stick Duo" after copying, then format the internal memory ([Format] in [Internal Memory Tool]).
- A new folder is created on the "Memory Stick Duo" and all the data will be copied to it. You cannot choose a specific folder and copy images to it.
- The **DPOF** (Print order) marks on the images are not copied.

Method for Formatting the Internal Memory

This item does not appear when a "Memory Stick Duo" is inserted in the camera.

Format

Formats the internal memory.

- Note that formatting permanently erases all data in the internal memory, including even protected images.

- ① Select [Format] with ▲/▼ on the control button, then press ●.
The message "All data on internal memory will be erased" appears.
- ② Select [OK] with ▲, then press ●.
Formatting starts.

To cancel formatting

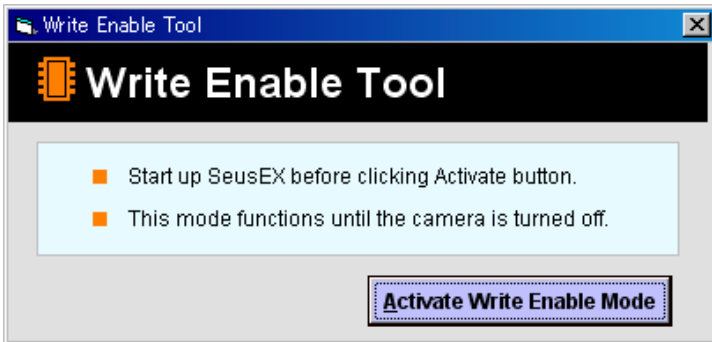
Select [Cancel] in step ②, then press ●.

1-5. HOW TO WRITE DATA TO INTERNAL MEMORY

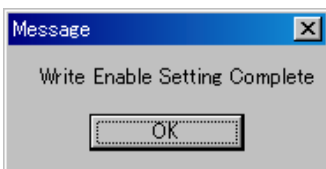
Usually, the camera has been set so as to disable the data writing from the PC to the internal memory of the camera. This setting must be changed temporarily when the data is to be written to the internal memory such as a case after the board replacement. To change the setting, use the write enable tool “WriteEnableTool.exe”.

Data writing method

- 1) Connect the PC to the camera (USB mode: Mass Storage), and switch the driver to the “Sony Seus USB Driver”.
- 2) Start the Write Enable Tool and the SeusEX.
- 3) Click the Activate Write Enable Mode button of the Write Enable Tool.



- 4) Upon completion of the setting change, the following message will be displayed.



- 5) Return the driver to the original one, and connect the PC to the camera (USB mode: Mass Storage).
- 6) Write the data read out into the PC to the internal memory of the camera.
- 7) Disconnect the PC from the camera, and turn off the camera.

Note: By turning off the camera, the write enable setting is reset.

1-4. 内蔵メモリのデータコピーおよび消去方法

内蔵メモリのデータコピーまたは消去はホーム画面の操作から実行可能です。（消去する場合は内蔵メモリの初期化を行います。）

Note1：SY-194基板交換の際は、基板交換前に内蔵メモリのデータを消去して下さい。

Note2：SY-194基板交換の際は、基板交換後に内蔵メモリのフォーマットおよび初期化を実行して下さい。

内蔵メモリのコピー方法

コピー

内蔵メモリーに記録した画像を、“メモリースティック デュオ”に一括コピーします。

- ① 十分な空き容量のある“メモリースティック デュオ”を本体に入れる。
- ② コントロールボタンの▲/▼で[コピー]を選び、中央の●を押す。
「内蔵メモリーのデータがすべてコピーされます」というメッセージが表示される。
- ③ ▲で[実行]を選び、中央の●を押す。
コピーが実行される。

コピーを中止するには

手順③で、[キャンセル]を選び、中央の●を押す。

- 十分に充電したバッテリーをご使用ください。残量の少ないバッテリーを使用して画像ファイルをコピーすると、バッテリー切れのためデータを転送できなかったり、データを破損するおそれがあります。
- 画像ごとのコピーはできません。
- データをコピーしても、内蔵メモリー内のデータは削除されません。内蔵メモリーの内容を消去するには、コピー後に“メモリースティックデュオ”を本体から取りはずし、[内蔵メモリー ツール]の[フォーマット]を行ってください。
- データをコピーすると“メモリースティック デュオ”内に新しいフォルダが作成されます。コピー先のフォルダを指定することはできません。
- データのコピーを行っても、**DPOF**(プリント予約)マークの設定はコピーされません。

内蔵メモリのフォーマット方法

“メモリースティック デュオ”が本機に入っている場合は表示されません。

フォーマット

内蔵メモリーの管理領域をフォーマット(初期化)します。

- フォーマットすると、プロテクトしてある画像も含めて、すべてのデータが消去され、元に戻せません。
- ① コントロールボタンの▲/▼で[フォーマット]を選び、中央の●を押す。
「内蔵メモリーのデータがすべて消去されます」というメッセージが表示される。
 - ② ▲で[実行]を選び、中央の●を押す。
フォーマットが実行される。

フォーマットを中止するには

手順②で、[キャンセル]を選び、中央の●を押す。

1-5. 内蔵メモリヘデータを書き戻す方法

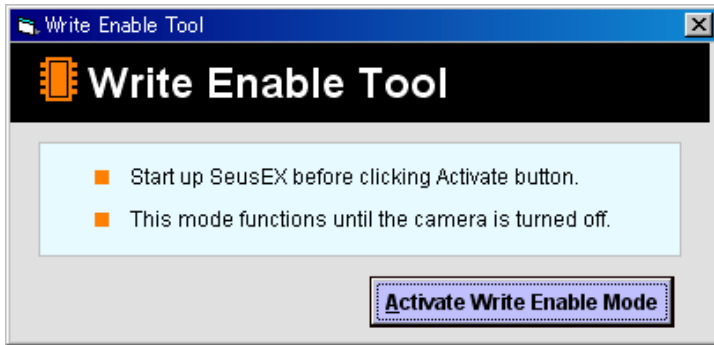
通常は、PCからカメラの内蔵メモリヘデータを書き込むことはできない設定になっています。

基板交換後などに、内蔵メモリヘデータを書き戻す場合には、この設定を一時的に変更する必要があります。

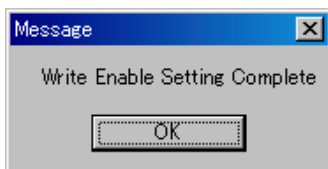
設定の変更には、書き込み許可ツール（WriteEnableTool.exe）を使用します。

書き戻し方法

- 1) カメラとPCをマストレージ接続し、ドライバを“Sony Seus USB Driver”に切り替える。
- 2) 書き込み許可ツールとSeusEXを起動する。
- 3) 書き込み許可ツールの[Activate Write Enable Mode]ボタンをクリックする。



- 4) 設定の変更が終了すると、次のメッセージが表示されます。



- 5) ドライバを元に戻して、カメラとPCをマストレージ接続する。
- 6) PCに読み出しておいたデータをカメラの内蔵メモリに書き込む。
- 7) カメラとPCの接続を解除し、カメラの電源をOFFにする。

注意：カメラの電源をOFFにすることにより、書き込み許可の設定が解除されます。

4-2. SCHEMATIC DIAGRAMS

Link

• SY-194 BOARD (1/10) (CCD SIGNAL PROCESS)	• SY-194 BOARD (6/10) (CPU (SIGNAL PROCESS 3))
• SY-194 BOARD (2/10) (LENS DRIVE)	• SY-194 BOARD (7/10) (AUDIO, VIDEO)
• SY-194 BOARD (3/10) (OIS DRIVE)	• SY-194 BOARD (8/10) (BATTERY DETECTOR, CLOCK GENERATOR)
• SY-194 BOARD (4/10) (CPU (SIGNAL PROCESS 1))	• SY-194 BOARD (9/10) (DC/DC CONVERTER)
• SY-194 BOARD (5/10) (CPU (SIGNAL PROCESS 2))	• SY-194 BOARD (10/10) (CONNECTOR)

• COMMON NOTE FOR SCHEMATIC DIAGRAMS

4. PRINTED WIRING BOARDS AND SCHEMATIC DIAGRAMS

4-2. SCHEMATIC DIAGRAMS

THIS NOTE IS COMMON FOR SCHEMATIC DIAGRAMS

(In addition to this, the necessary note is printed in each block)

(For schematic diagrams)

- All capacitors are in μF unless otherwise noted. pF : μF . 50 V or less are not indicated except for electrolytics and tantalums.
- Chip resistors are 1/10 W unless otherwise noted. $\text{k}\Omega=1000 \Omega$, $\text{M}\Omega=1000 \text{k}\Omega$.
- Caution when replacing chip parts.
New parts must be attached after removal of chip.
Be careful not to heat the minus side of tantalum capacitor. Because it is damaged by the heat.
- Some chip part will be indicated as follows.

Example	C541	L452
	22U	10UH
	TA A	2520
	TA	A
Kinds of capacitor		External dimensions (mm)
	Case size	

- Constants of resistors, capacitors, ICs and etc with XX indicate that they are not used.
In such cases, the unused circuits may be indicated.
- Parts with ★ differ according to the model/destination. Refer to the mount table for each function.
- All variable and adjustable resistors have characteristic curve B, unless otherwise noted.
- Signal name
XEDIT → EDIT PB/XREC → PB/REC
- : non flammable resistor
- : fusible resistor
- : panel designation
- : B+ Line
- : B- Line
- : IN/OUT direction of (+,-) B LINE.
- : adjustment for repair.

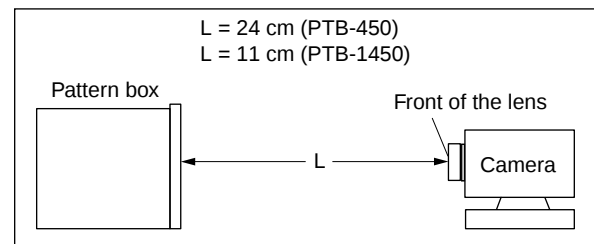
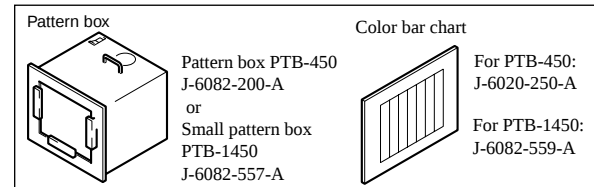
(Measuring conditions voltage and waveform)

- Voltages and waveforms are measured between the measurement points and ground when camera shoots color bar chart of pattern box. They are reference values and reference waveforms.
(VOM of DC 10 M Ω input impedance is used)
- Voltage values change depending upon input impedance of VOM used.)

Precautions for Replacement of Imager

- If the imager has been replaced, carry out all the adjustments for the camera section.
- As the imager may be damaged by static electricity from its structure, handle it carefully like for the MOS IC.
In addition, ensure that the receiver is not covered with dusts nor exposed to strong light.

1. Connection



2. Adjust the distance so that the output waveform of Fig. a and the Fig. b can be obtain.

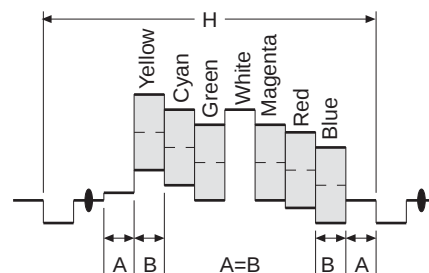


Fig. a (Video output terminal output waveform)

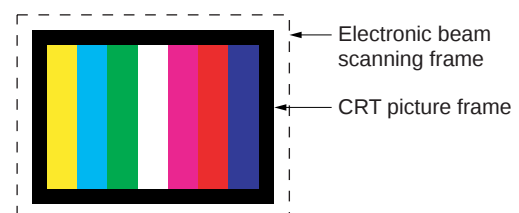


Fig.b (Picture on monitor TV)

When indicating parts by reference number, please include the board name.

The components identified by mark $\triangle$ or dotted line with mark $\triangle$ are critical for safety.
Replace only with part number specified.

Les composants identifiés par une marque $\triangle$ sont critiques pour la sécurité.
Ne les remplacer que par une pièce portant le numéro spécifié.

(JAPANESE)

回路図共通ノート

(他に必要なノートは各ブロックに記載してあります)

【回路図ノート】

- ・ケミコン、タンタルを除くコンデンサで、耐圧50V以下のものはその耐圧を省略。単位はすべて μF (pはpF)。
- ・チップ抵抗で指示のないものは、 $1/10\text{W}$ 以下。
 $k\Omega=1000\Omega$, $M\Omega=1000k\Omega$
- ・チップ部品交換時の注意
 取り外した部品は再使用せず、未使用の部品をご使用ください。
 タンタルコンデンサのマイナス側は熱に弱いので注意してください。

- ・チップ部品には下記のように表示したものがあります。

例	C 541	L 452
	22U	10UH
	TA A	2520
	↑	↑
	種類 ケースサイズ	外形寸法 (mm)

- ・抵抗、コンデンサ、ICなど定数にXXがあるものは、使用していない事を示しています。このため、使用していない回路が記載されている事があります。
- ・★印のある部品は、機種などにより異なりますので機能別マウンティング表を参照してください。
- ・可変抵抗と半固定抵抗で、B特性の表示を省略。
- ・信号名表記について、下記のような場合があります。
 XEDIT → EDIT PB/XREC → PB/REC

- ・ は不燃性抵抗。
- ・ はヒューズ抵抗。
- ・ はパネル表示名称。
- ・ はB+ライン。
- ・ はB-ライン。
- ・ はBライン (+, -) の入出力方向を示す。
- ・ は調整名称。

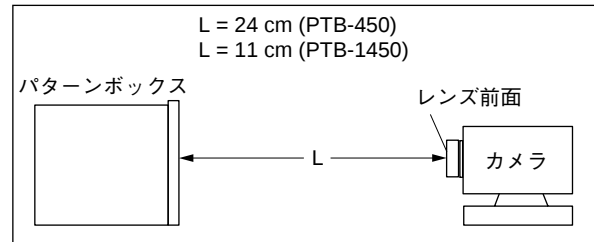
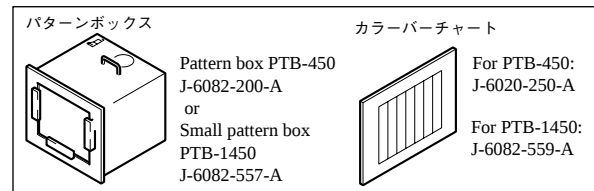
【電圧・波形測定条件ノート】

- ・電圧値及び信号波形はパターンボックスのカラーバーチャートを被写体としたときの測定点对アース間の参考値。
 (デジタルマルチメータ; 入力インピーダンス $DC10M\Omega$ 使用)
- ・使用テストの入力インピーダンスにより電圧値が多少異なります。

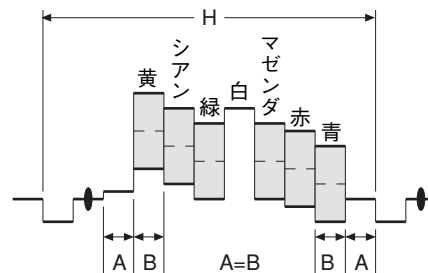
イメージ交換時の注意

- ・イメージを交換した場合は、カメラ部の全調整を行ってください。
- ・イメージは構造上、静電気により破壊される恐れがあるため、MOS ICと同様に注意して取り扱ってください。
 また、受光部にはゴミの付着、および強い光はいることのないように注意してください。

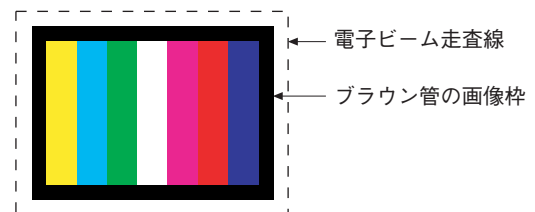
1. 接続図



- 2. 図a及び図bの波形が得られるように画枠調整して下さい。



図a (映像入出力端子出力波形)

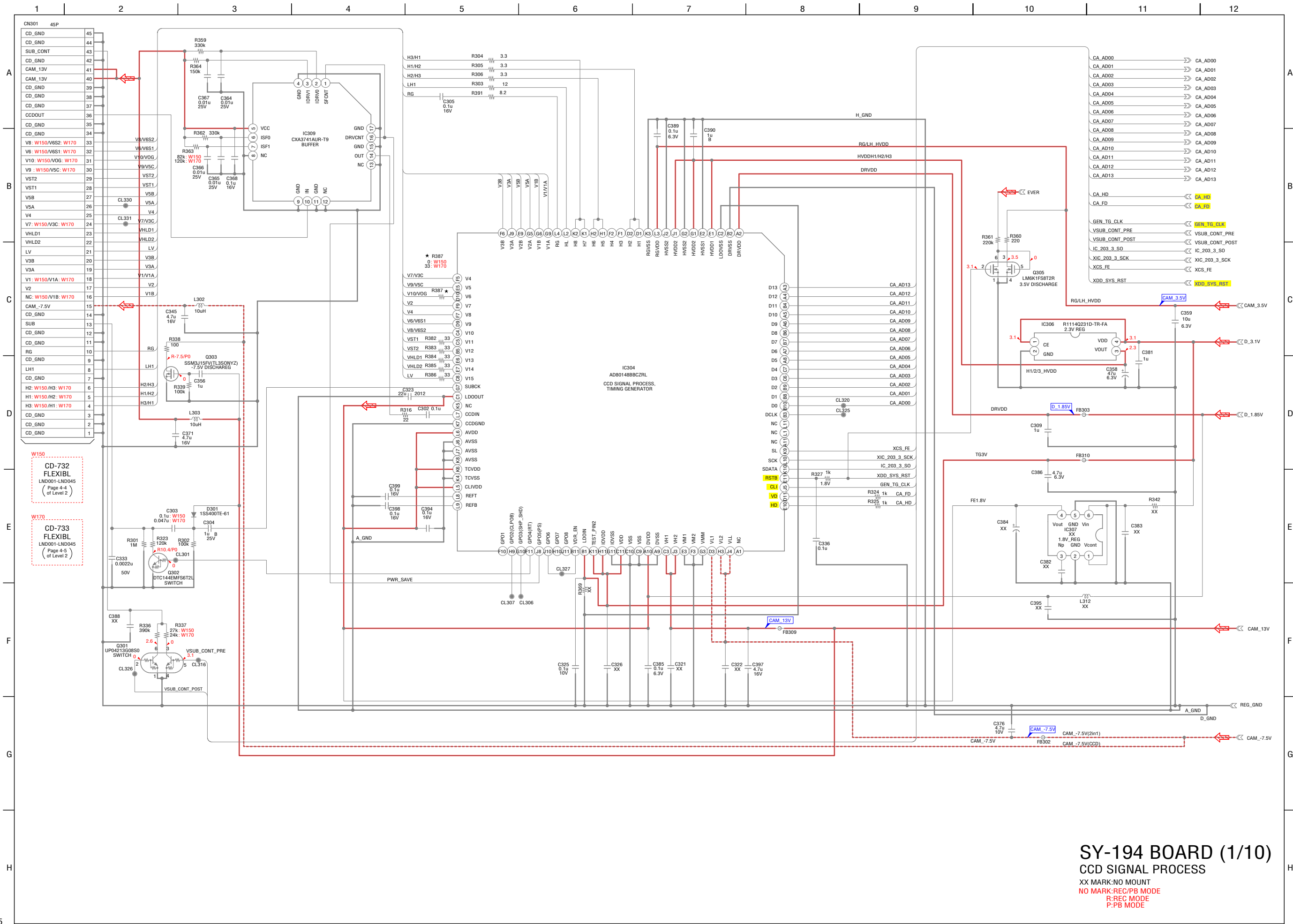


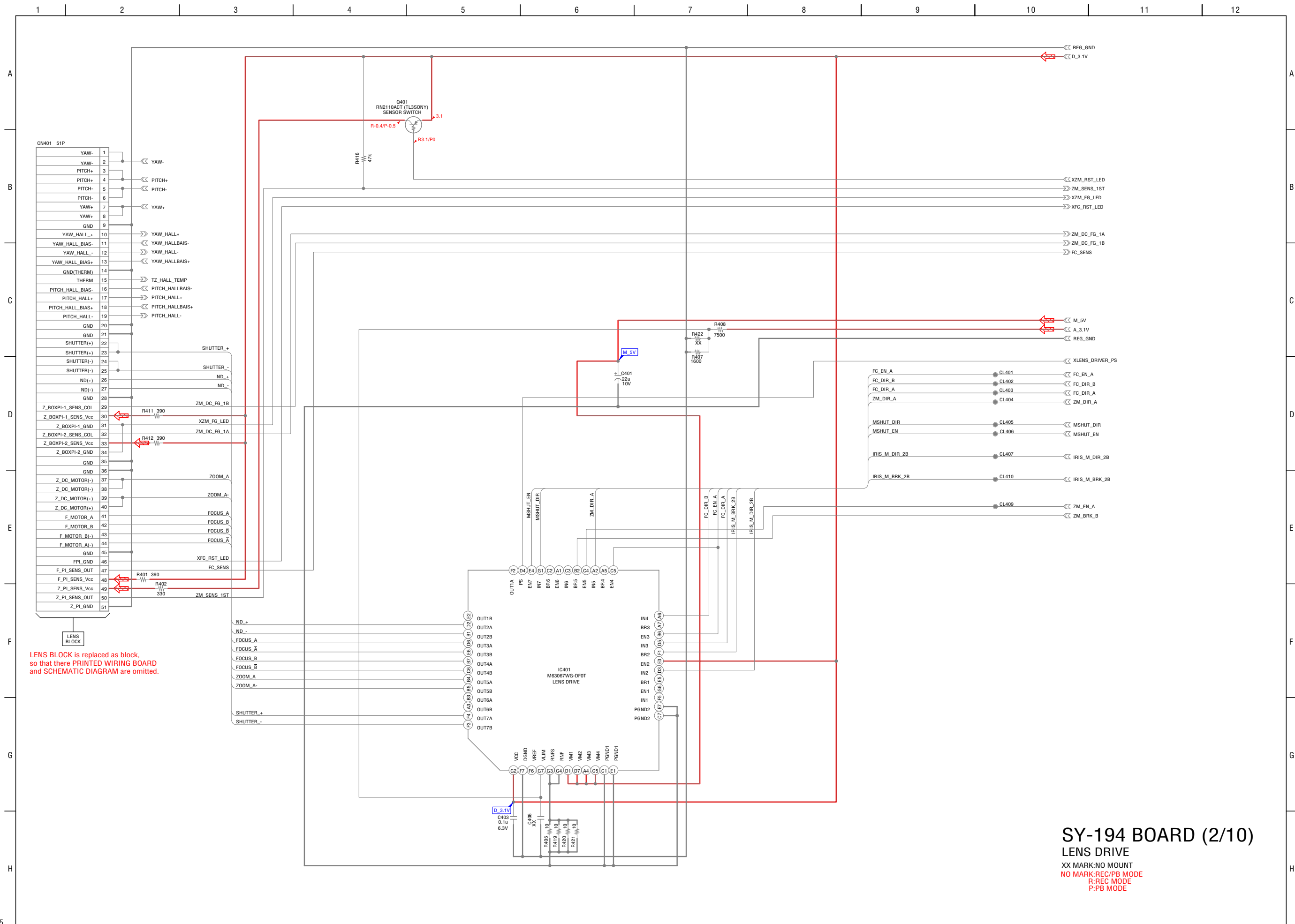
図b (テレビモニタの映像)

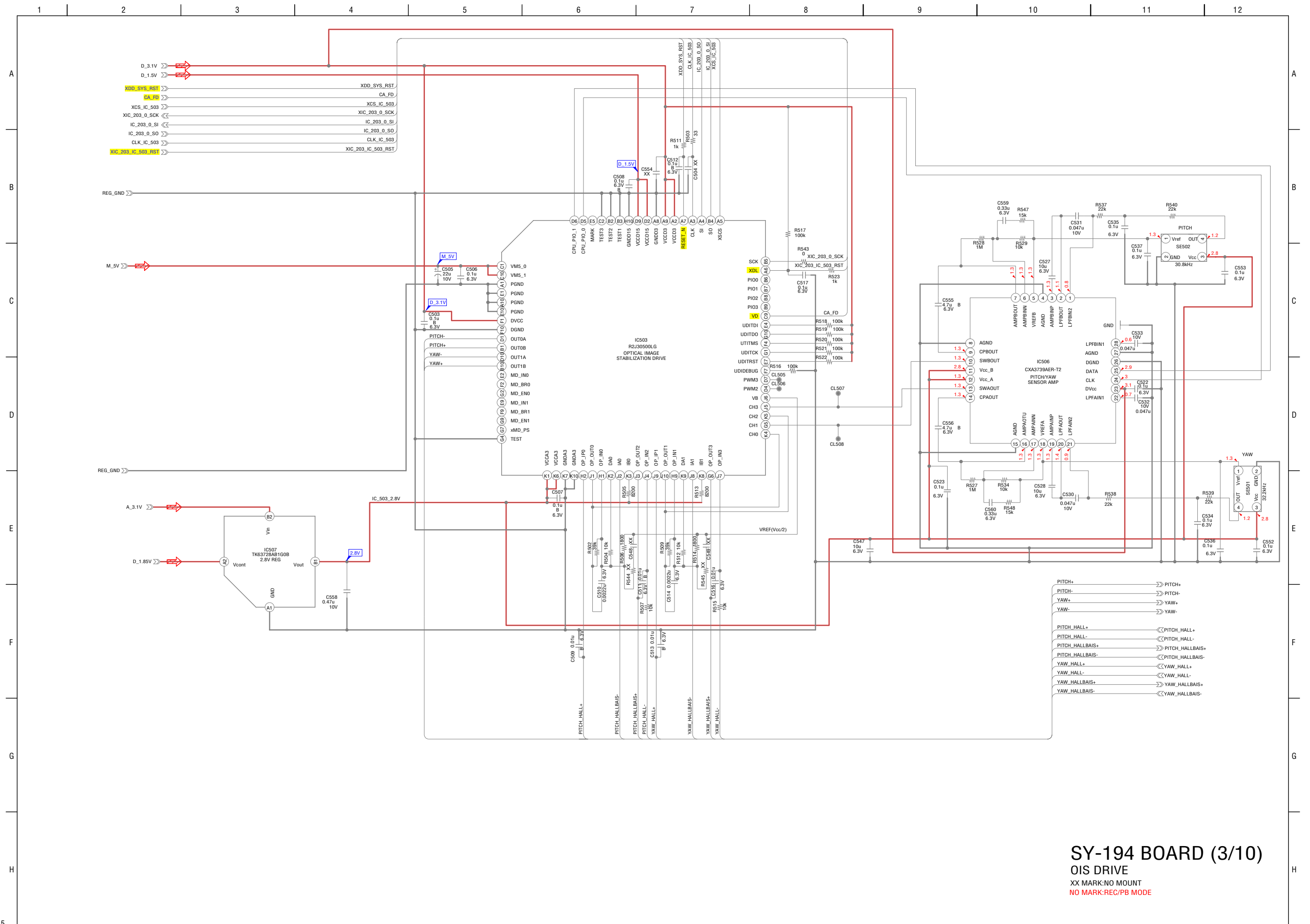
△印の部品、または△印付きの点線で囲まれた部品は、安全性を維持するために重要な部品です。従って交換時は、必ず指定の部品を使用して下さい。

お願い

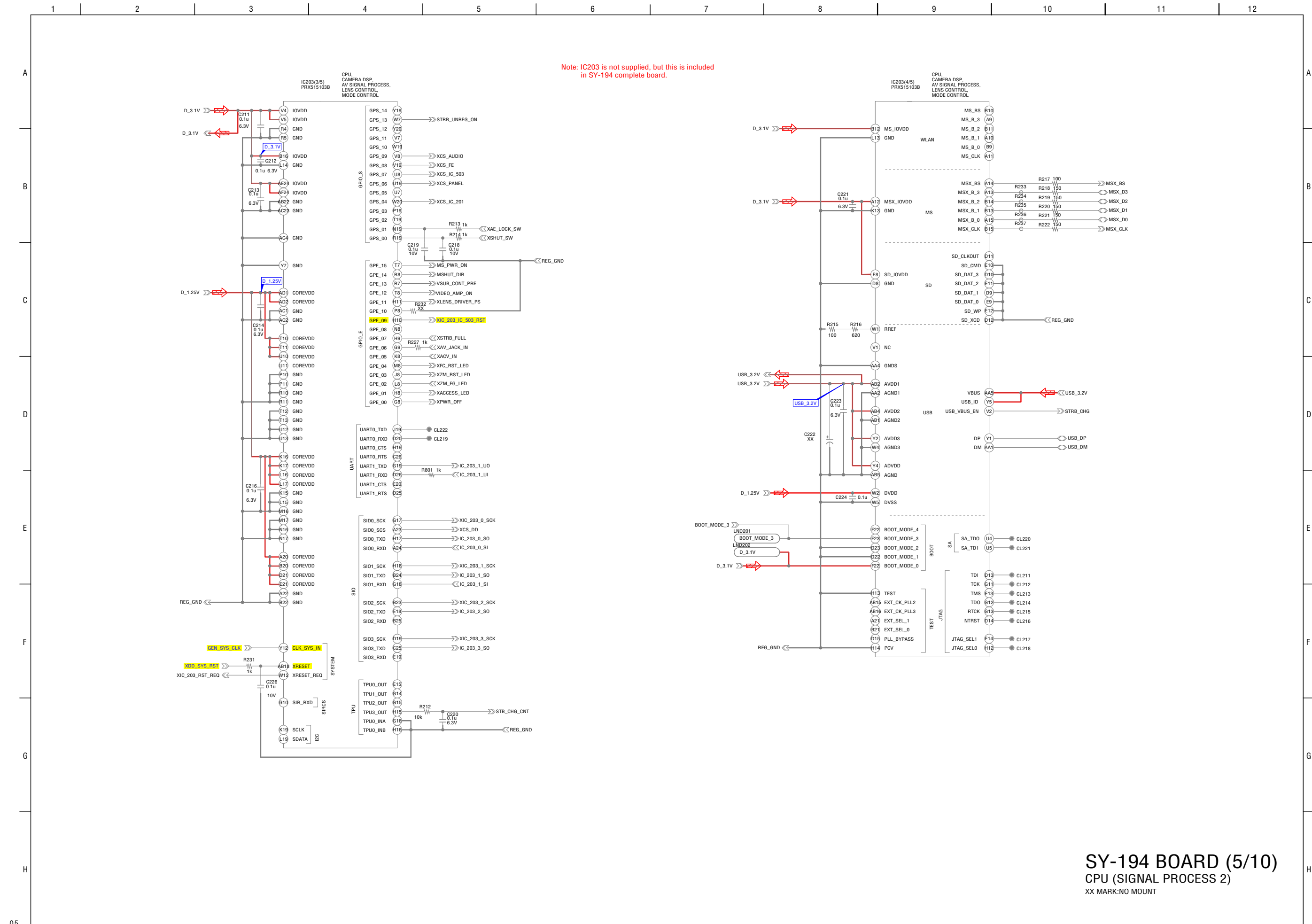
図面番号で部品を指定するときは基板名又はブロックを併せて指定して下さい。

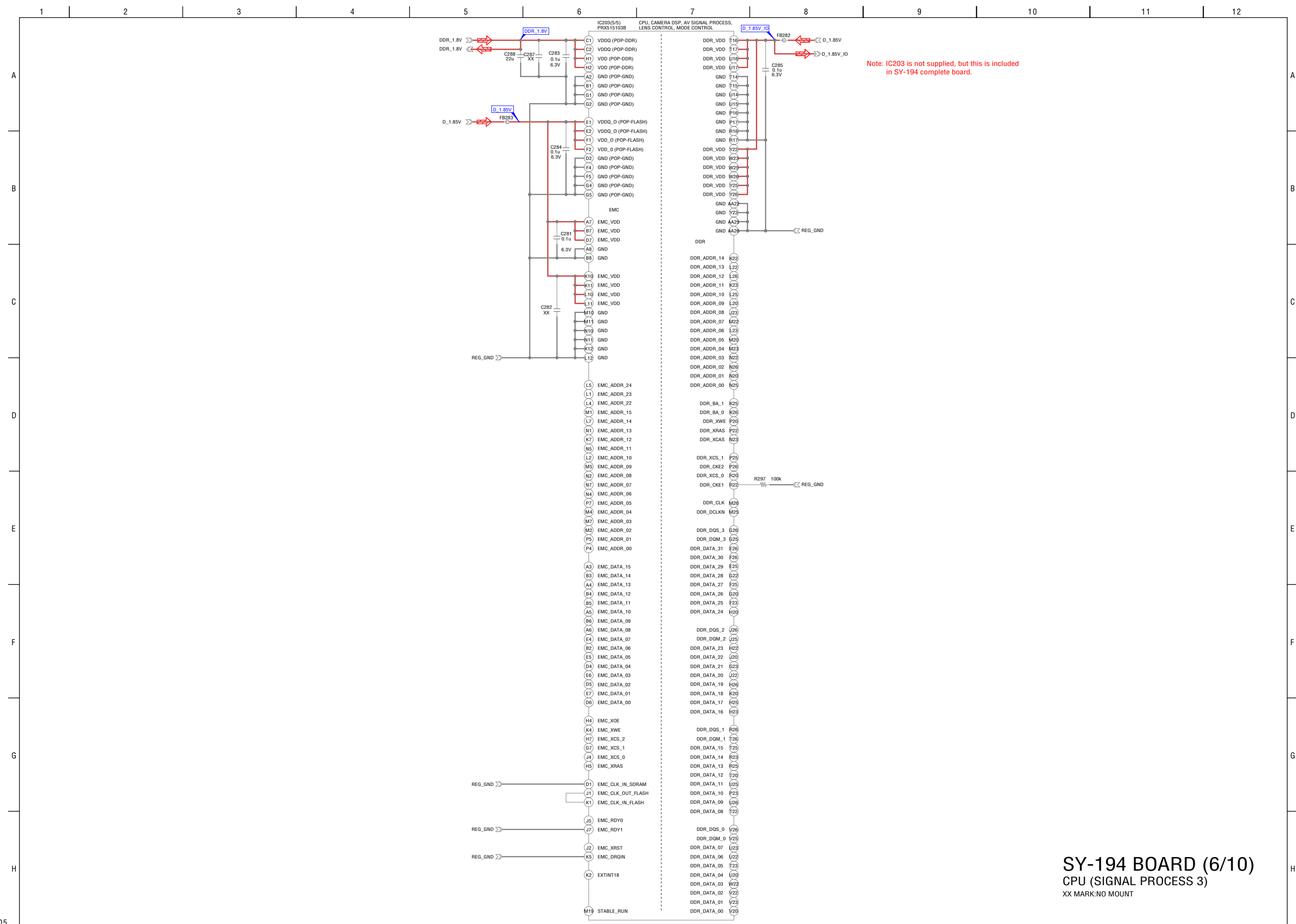


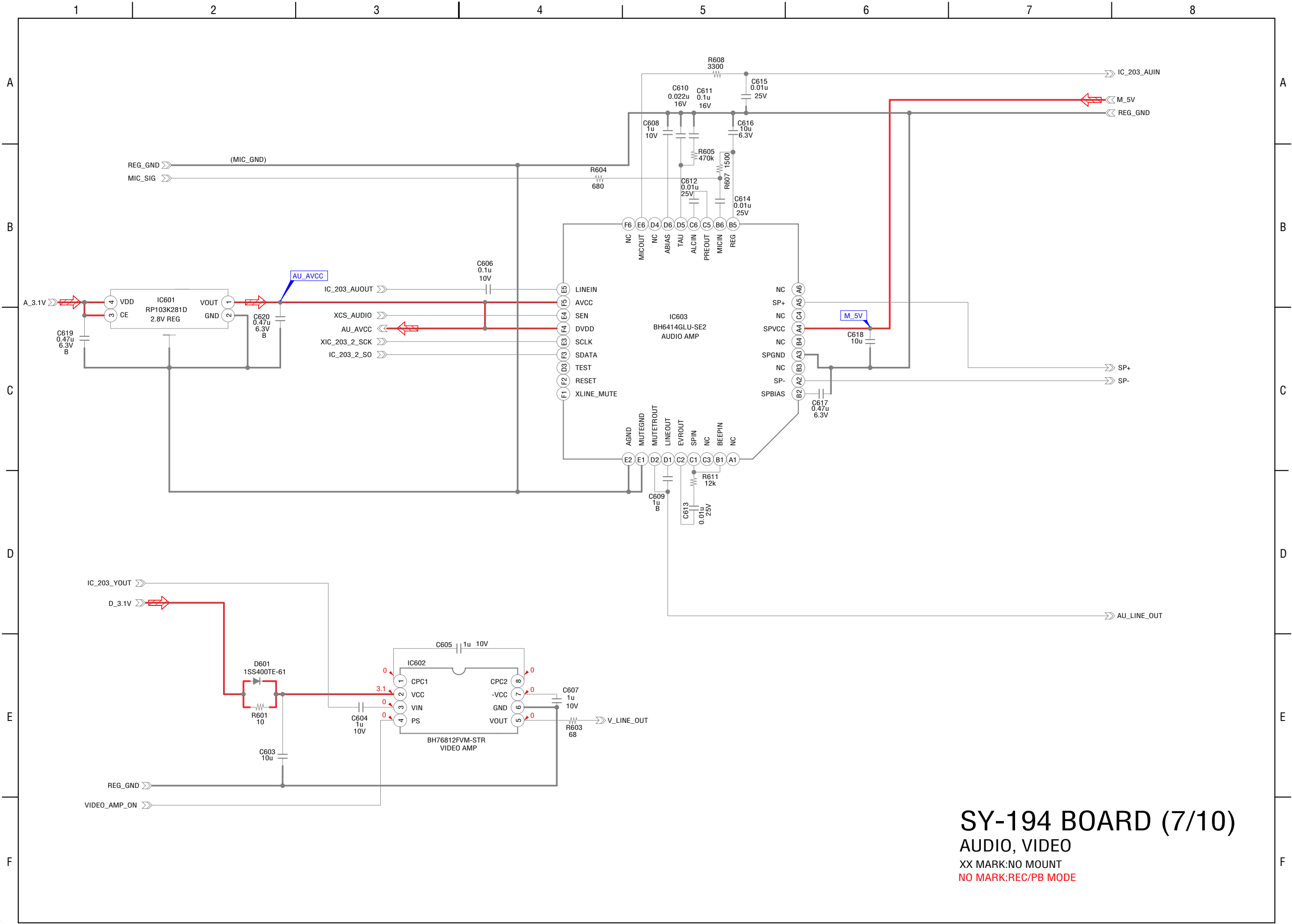


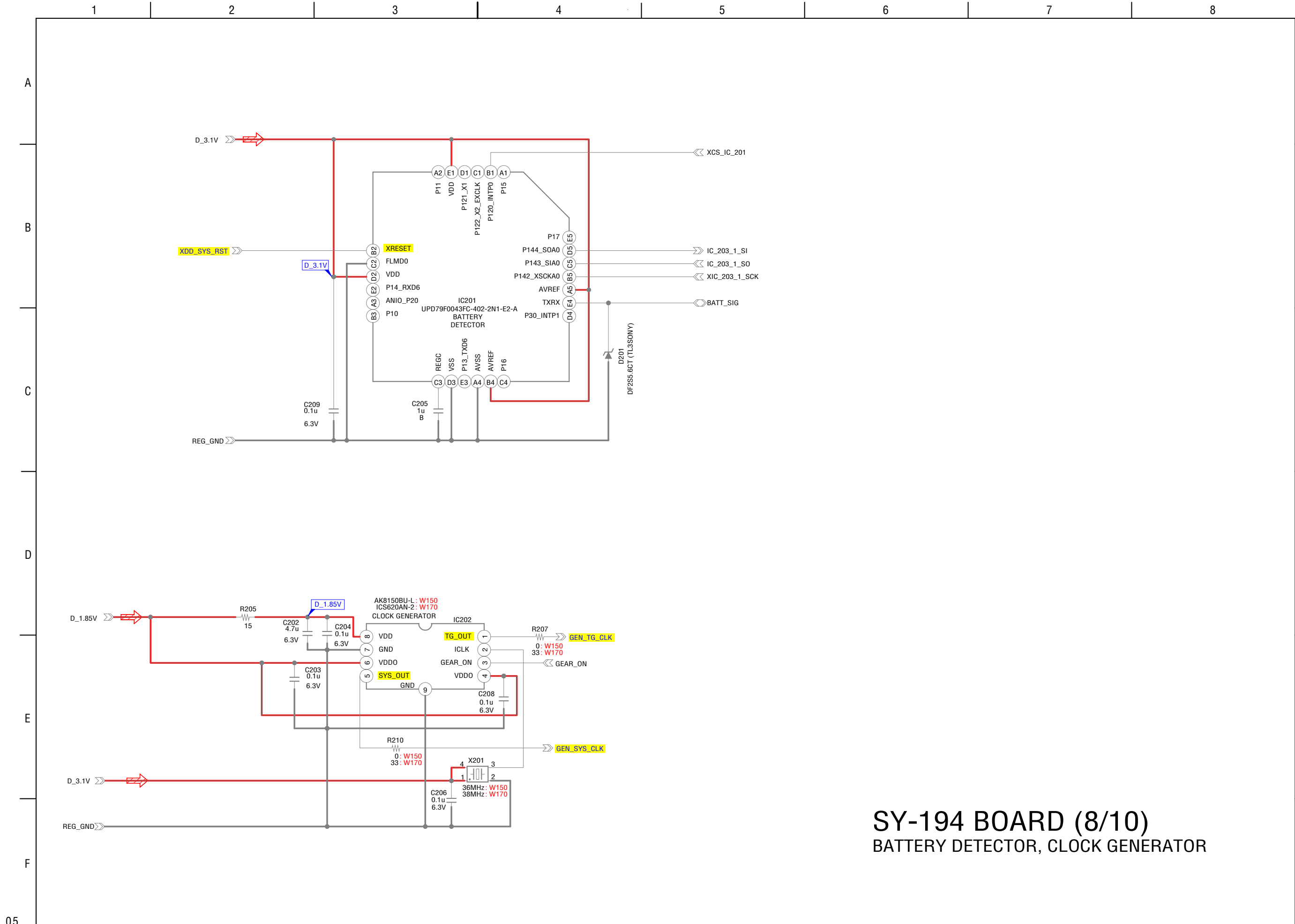






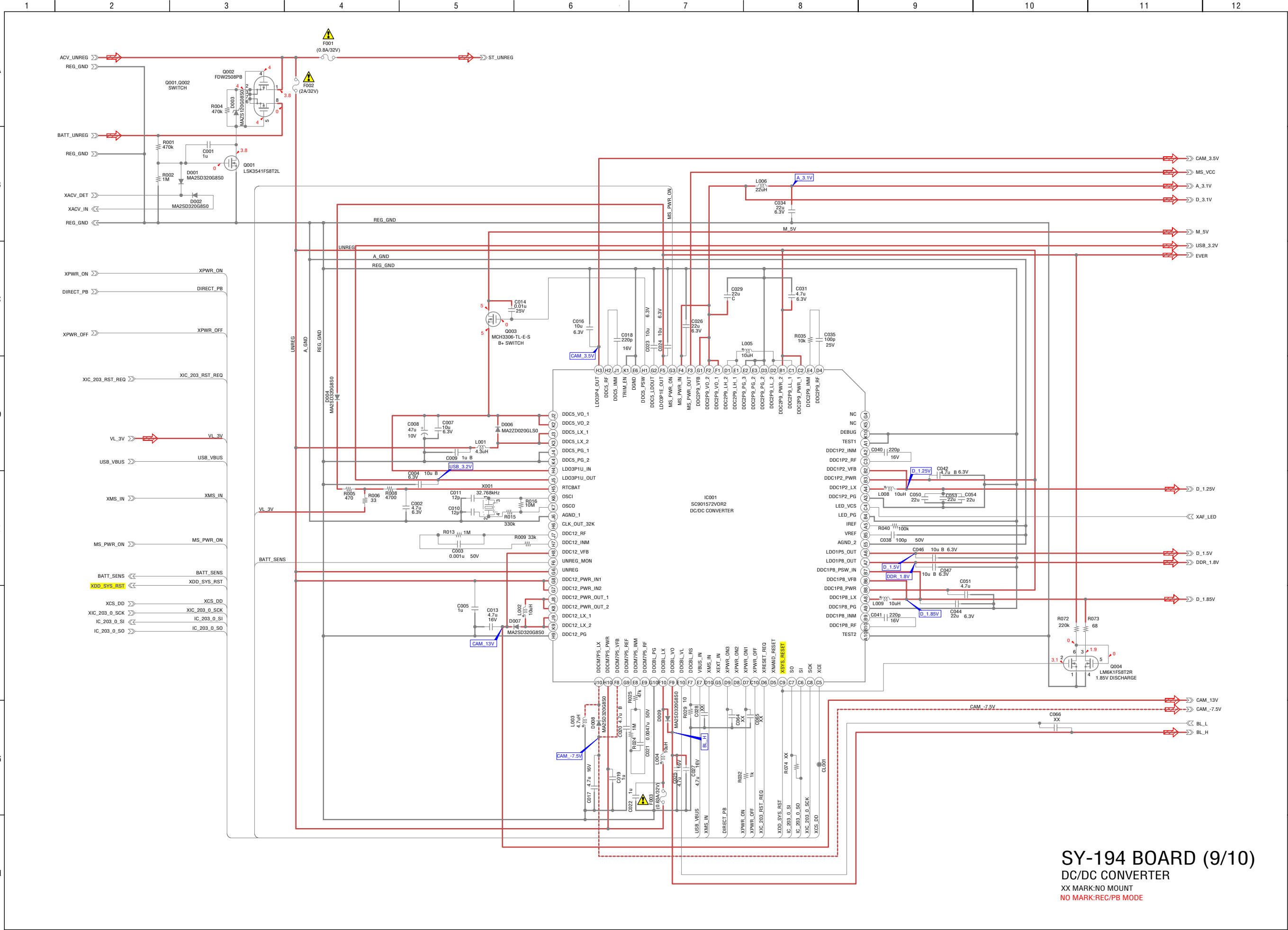




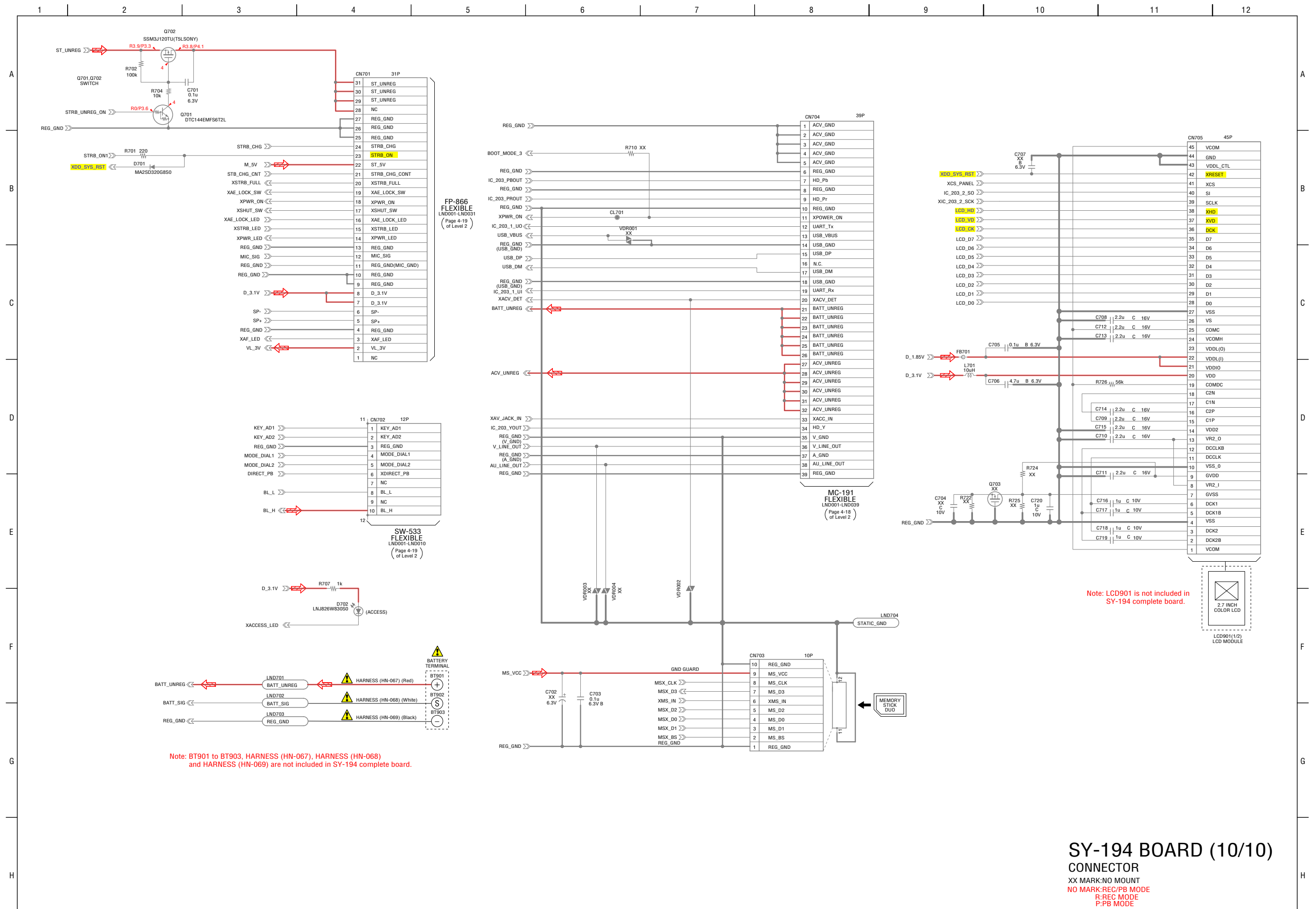


SY-194 BOARD (8/10)
BATTERY DETECTOR, CLOCK GENERATOR

• Refer to page 4-2 (English), 4-3 (Japanese) for mark △.



- Refer to page 4-2 (English), 4-3 (Japanese) for mark $\triangle$.



4-3. PRINTED WIRING BOARDS

Link

- **SY-194 BOARD**

- **COMMON NOTE FOR PRINTED WIRING BOARDS**

4-3. PRINTED WIRING BOARDS

4-3. PRINTED WIRING BOARDS

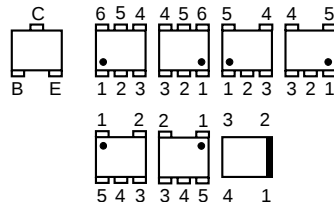
(ENGLISH)

THIS NOTE IS COMMON FOR PRINTED WIRING BOARDS

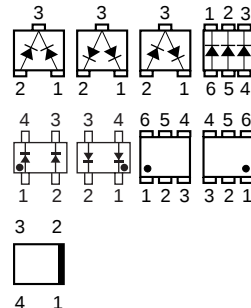
-  : Uses unleaded solder.
-  : Circuit board
-  : Flexible board
-  : Pattern from the side which enables seeing.
-  : pattern of the rear side
(The other layers' patterns are not indicated)
- Through hole is omitted.
- There are a few cases that the part printed on diagram isn't mounted in this model.
-  : panel designation

- Chip parts.

Transistor



Diode



(JAPANESE)

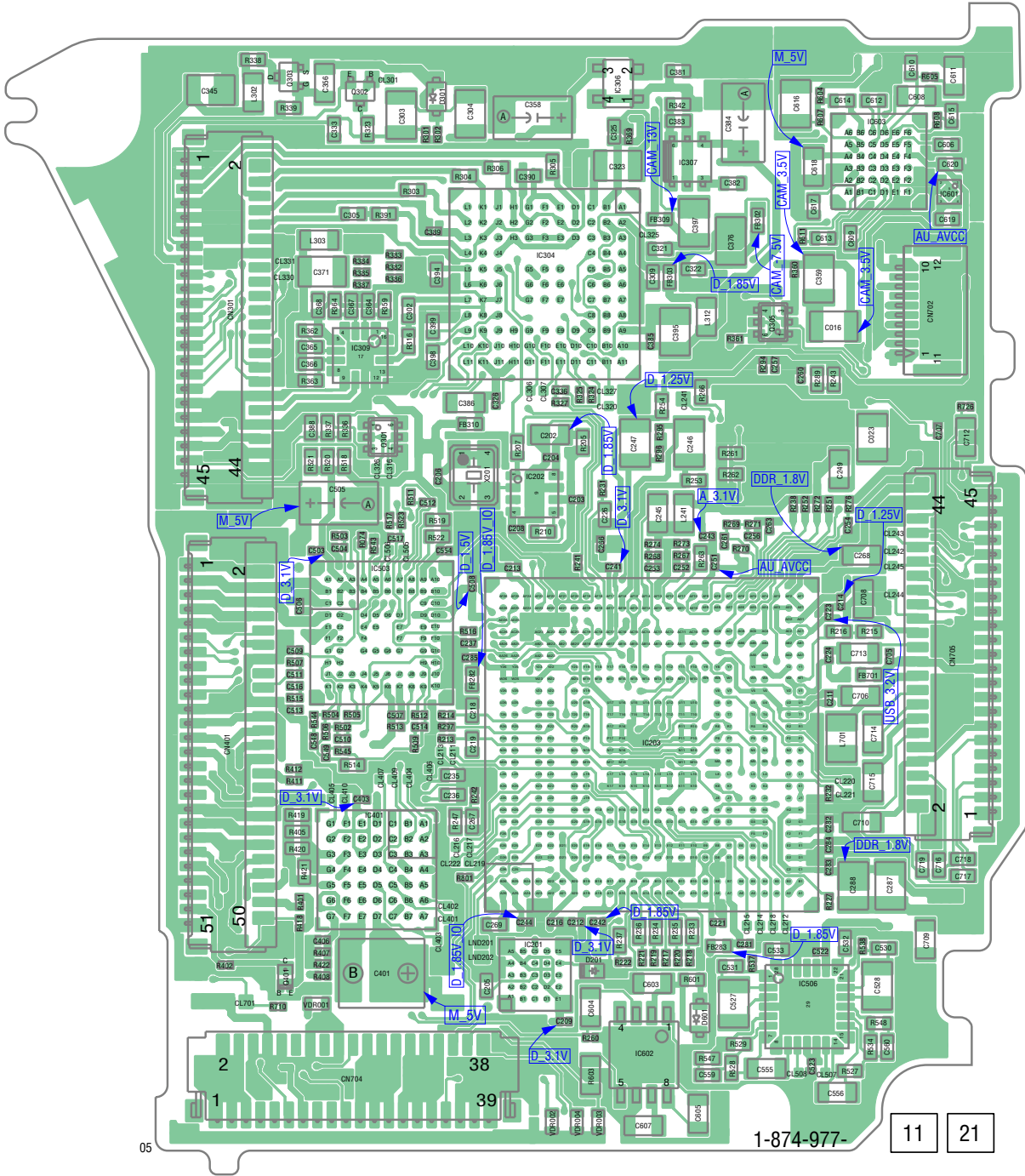
プリント図共通ノート

【プリント図ノート】

-  : 無鉛半田を使用しています。
-  : 基板
-  : フレキシブル配線板
-  : 見ている面側のパターン。
-  : 裏側のパターン
(他のパターンについては表示されていません)
- スルーホールは省略。
- プリント図には、本機で使用していない部品が記載されている場合があります。
-  はパネル表示名称。

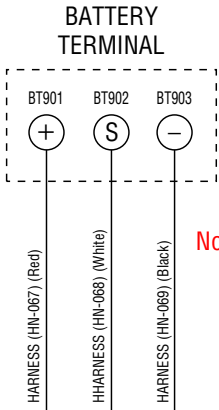
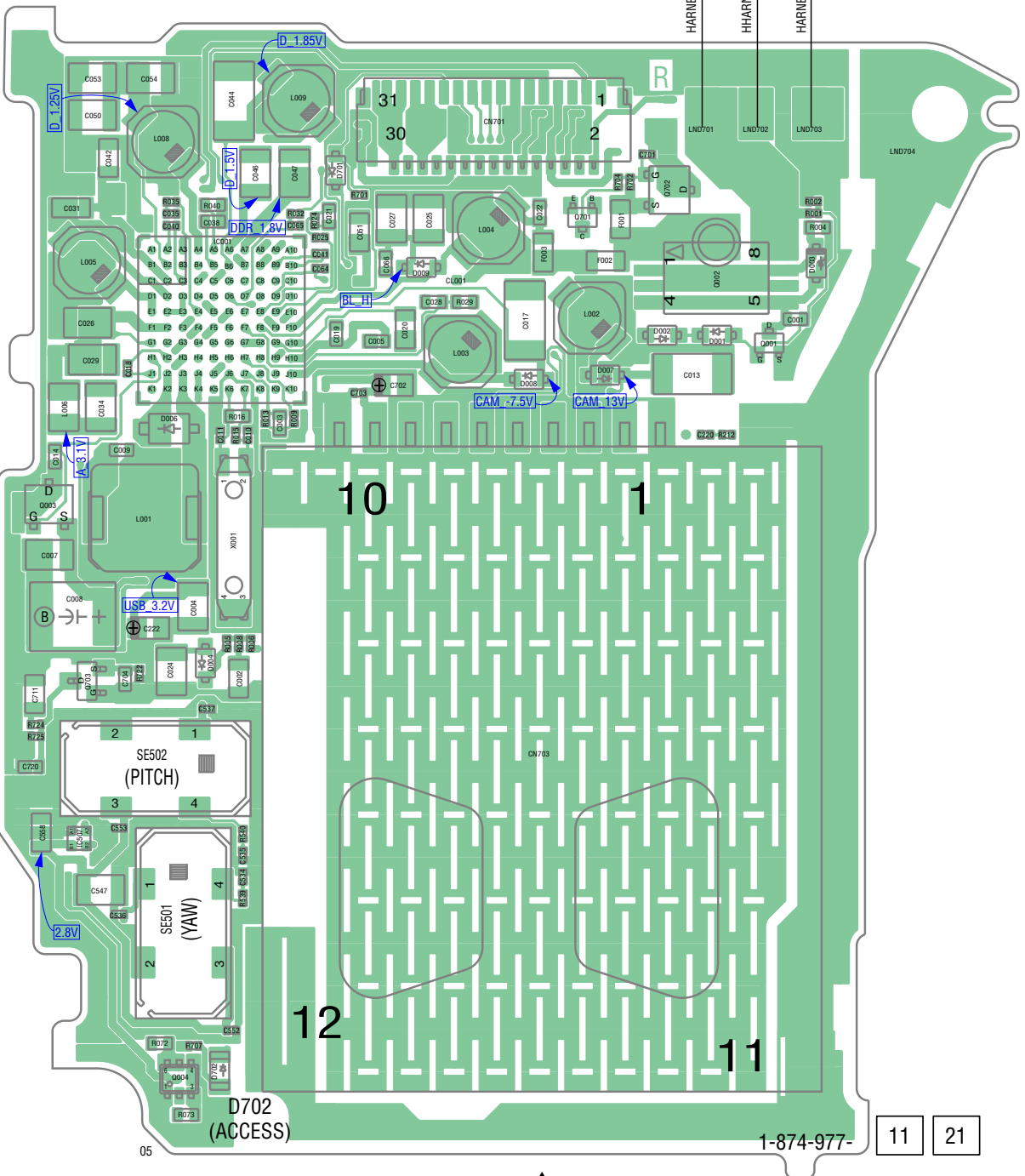
SY-194 (8 layers)
 : Uses unleaded solder.

SY-194 BOARD (SIDE A)

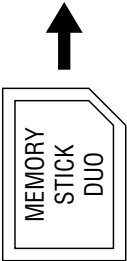


Note: IC203 is not supplied, but this is included in SY-194 complete board.

SY-194 BOARD (SIDE B)



Note: BT901 to BT903, HARNESS (HN-067), HARNESS (HN-068) and HARNESS (HN-069) are not included in SY-194 complete board.



5. REPAIR PARTS LIST

(ENGLISH)

NOTE:

- -XX, -X mean standardized parts, so they may have some differences from the original one.
- Items marked “*” are not stocked since they are seldom required for routine service. Some delay should be anticipated when ordering these items.
- The mechanical parts with no reference number in the exploded views are not supplied.
- Due to standardization, replacements in the parts list may be different from the parts specified in the diagrams or the components used on the set.
- CAPACITORS:
uF: μ F
- COILS
uH: μ H
- RESISTORS
All resistors are in ohms.
METAL: metal-film resistor
METAL OXIDE: Metal Oxide-film resistor
F: nonflammable
- SEMICONDUCTORS
In each case, u: μ , for example:
uA...: μ A..., uPA..., μ PA...,
uPB..., μ PB..., uPC..., μ PC...,
uPD..., μ PD...

When indicating parts by reference number, please include the board name.

The components identified by mark $\triangle$ or dotted line with mark $\triangle$ are critical for safety. Replace only with part number specified.

Les composants identifiés par une marque $\triangle$ sont critiques pour la sécurité. Ne les remplacer que par une pièce portant le numéro spécifié.

- Color Indication of Appearance Parts
Example:
(SILVER) : Cabinet's Color
(Silver) : Parts Color

(JAPANESE)

【使用上の注意】

- ここに記載されている部品は、補修用部品であるため、回路図及びセットに付いている部品と異なる場合があります。
- -XX, -Xは標準化部品のため、セットに付いている部品と異なる場合があります。
- *印の部品は常備在庫しておりません。
- コンデンサの単位でuFは μ Fを示します。
- 抵抗の単位 Ω は省略してあります。
金 被：金属被膜抵抗。
サンキン：酸化金属被膜抵抗。
- インダクタの単位でuHは μ Hを示します。
- 半導体の名称でuA..., uPA..., uPB..., uPC..., uPD...等はそれぞれ μ A..., μ PA..., μ PB..., μ PC..., μ PD...を示します。

お願い

図面番号で部品を指定するときは基板名又はブロックを併せて指定してください。

$\triangle$ 印の部品、または $\triangle$ 印付の点線で囲まれた部品は、安全性を維持するために、重要な部品です。従って交換時は、必ず指定の部品を使用してください。

- 外装部品色表示
例：
(SILVER):セットの色を表す。
(Silver) : 部品の色を表す。

- Abbreviation
AR : Argentine model
AUS : Australian model
BR : Brazilian model
CH : Chinese model
CND : Canadian model
EE : East European model
HK : Hong Kong model
J : Japanese model
JE : Tourist model
KR : Korea model
NE : North European model
TW : Taiwan model

5-2. ELECTRICAL PARTS LIST

Ref. No.	Part No.	Description	Ref. No.	Part No.	Description
	A-1528-440-A	SY-194 BOARD, COMPLETE (SERVICE) (W150)	* C216	1-112-716-11	CERAMIC CHIP 0.1uF 10% 6.3V
	A-1528-438-A	SY-194 BOARD, COMPLETE (SERVICE) (W170)	C218	1-125-777-11	CERAMIC CHIP 0.1uF 10% 10V
	*****		C219	1-125-777-11	CERAMIC CHIP 0.1uF 10% 10V
	(IC203 is not supplied, but this is included in SY-194 complete board.)		* C220	1-112-716-11	CERAMIC CHIP 0.1uF 10% 6.3V
			* C221	1-112-716-11	CERAMIC CHIP 0.1uF 10% 6.3V
	< CAPACITOR >				
	C001	1-112-717-91 CERAMIC CHIP 1uF 10% 6.3V	* C223	1-112-716-11	CERAMIC CHIP 0.1uF 10% 6.3V
* C002	1-112-746-11	CERAMIC CHIP 4.7uF 10% 6.3V	* C224	1-112-716-11	CERAMIC CHIP 0.1uF 10% 6.3V
C003	1-164-937-11	CERAMIC CHIP 0.001uF 10% 50V	C226	1-125-777-11	CERAMIC CHIP 0.1uF 10% 10V
C004	1-165-989-11	CERAMIC CHIP 10uF 10% 6.3V	C235	1-164-937-11	CERAMIC CHIP 0.001uF 10% 50V
C005	1-112-717-91	CERAMIC CHIP 1uF 10% 6.3V	C236	1-164-937-11	CERAMIC CHIP 0.001uF 10% 50V
			C237	1-128-627-91	CERAMIC CHIP 0.001uF 10% 16V
C007	1-165-989-11	CERAMIC CHIP 10uF 10% 6.3V	* C241	1-112-716-11	CERAMIC CHIP 0.1uF 10% 6.3V
* C008	1-112-662-91	TANTAL. CHIP 47uF 20% 10V	* C242	1-112-716-11	CERAMIC CHIP 0.1uF 10% 6.3V
C009	1-112-717-91	CERAMIC CHIP 1uF 10% 6.3V	* C243	1-112-716-11	CERAMIC CHIP 0.1uF 10% 6.3V
C010	1-128-605-11	CERAMIC CHIP 12PF 5% 25V	* C244	1-112-716-11	CERAMIC CHIP 0.1uF 10% 6.3V
C011	1-128-605-11	CERAMIC CHIP 12PF 5% 25V			
			* C245	1-112-746-11	CERAMIC CHIP 4.7uF 10% 6.3V
C013	1-127-820-11	CERAMIC CHIP 4.7uF 10% 16V	C246	1-100-611-91	CERAMIC CHIP 22uF 20% 6.3V
C014	1-100-567-81	CERAMIC CHIP 0.01uF 10% 25V	C247	1-100-611-91	CERAMIC CHIP 22uF 20% 6.3V
C016	1-165-989-11	CERAMIC CHIP 10uF 10% 6.3V	C249	1-165-884-11	CERAMIC CHIP 2.2uF 10% 6.3V
C017	1-127-820-11	CERAMIC CHIP 4.7uF 10% 16V	* C251	1-112-716-11	CERAMIC CHIP 0.1uF 10% 6.3V
C018	1-128-623-91	CERAMIC CHIP 220PF 10% 16V			
			* C252	1-112-716-11	CERAMIC CHIP 0.1uF 10% 6.3V
C019	1-112-717-91	CERAMIC CHIP 1uF 10% 6.3V	* C253	1-112-716-11	CERAMIC CHIP 0.1uF 10% 6.3V
* C020	1-112-746-11	CERAMIC CHIP 4.7uF 10% 6.3V	* C254	1-112-716-11	CERAMIC CHIP 0.1uF 10% 6.3V
C021	1-100-581-81	CERAMIC CHIP 0.0047uF 10% 50V	* C256	1-112-716-11	CERAMIC CHIP 0.1uF 10% 6.3V
C022	1-112-717-91	CERAMIC CHIP 1uF 10% 6.3V	* C257	1-112-716-11	CERAMIC CHIP 0.1uF 10% 6.3V
C023	1-165-989-11	CERAMIC CHIP 10uF 10% 6.3V			
			* C260	1-112-716-11	CERAMIC CHIP 0.1uF 10% 6.3V
C024	1-165-989-11	CERAMIC CHIP 10uF 10% 6.3V	* C261	1-112-716-11	CERAMIC CHIP 0.1uF 10% 6.3V
C025	1-100-670-11	CERAMIC CHIP 4.7uF 20% 16V	* C263	1-112-716-11	CERAMIC CHIP 0.1uF 10% 6.3V
C026	1-100-611-91	CERAMIC CHIP 22uF 20% 6.3V	* C266	1-112-716-11	CERAMIC CHIP 0.1uF 10% 6.3V
C027	1-100-670-11	CERAMIC CHIP 4.7uF 20% 16V	C267	1-164-937-11	CERAMIC CHIP 0.001uF 10% 50V
C029	1-100-611-91	CERAMIC CHIP 22uF 20% 6.3V			
			C268	1-165-884-11	CERAMIC CHIP 2.2uF 10% 6.3V
* C031	1-112-746-11	CERAMIC CHIP 4.7uF 10% 6.3V	C269	1-125-777-11	CERAMIC CHIP 0.1uF 10% 10V
C034	1-100-611-91	CERAMIC CHIP 22uF 20% 6.3V	* C281	1-112-716-11	CERAMIC CHIP 0.1uF 10% 6.3V
C035	1-128-617-91	CERAMIC CHIP 100PF 5% 25V	* C283	1-112-716-11	CERAMIC CHIP 0.1uF 10% 6.3V
C038	1-164-874-11	CERAMIC CHIP 100PF 5% 50V	* C284	1-112-716-11	CERAMIC CHIP 0.1uF 10% 6.3V
C040	1-128-623-91	CERAMIC CHIP 220PF 10% 16V			
			* C285	1-112-716-11	CERAMIC CHIP 0.1uF 10% 6.3V
C041	1-128-623-91	CERAMIC CHIP 220PF 10% 16V	C288	1-100-611-91	CERAMIC CHIP 22uF 20% 6.3V
* C042	1-112-746-11	CERAMIC CHIP 4.7uF 10% 6.3V	* C302	1-114-582-11	CERAMIC CHIP 0.1uF 10% 16V
C044	1-100-159-91	CERAMIC CHIP 22uF 10% 6.3V	C303	1-104-760-11	CERAMIC CHIP 0.047uF 10% 50V
C046	1-165-989-11	CERAMIC CHIP 10uF 10% 6.3V			(W170)
C047	1-165-989-11	CERAMIC CHIP 10uF 10% 6.3V	C303	1-115-339-11	CERAMIC CHIP 0.1uF 10% 50V
					(W150)
C050	1-100-611-91	CERAMIC CHIP 22uF 20% 6.3V			
* C051	1-112-746-11	CERAMIC CHIP 4.7uF 10% 6.3V	C304	1-100-591-91	CERAMIC CHIP 1uF 10% 25V
C053	1-100-611-91	CERAMIC CHIP 22uF 20% 6.3V	* C305	1-114-582-11	CERAMIC CHIP 0.1uF 10% 16V
C054	1-100-611-91	CERAMIC CHIP 22uF 20% 6.3V	C309	1-112-717-91	CERAMIC CHIP 1uF 10% 6.3V
* C202	1-112-746-11	CERAMIC CHIP 4.7uF 10% 6.3V	C323	1-100-611-91	CERAMIC CHIP 22uF 20% 6.3V
			C325	1-125-777-11	CERAMIC CHIP 0.1uF 10% 10V
* C203	1-112-716-11	CERAMIC CHIP 0.1uF 10% 6.3V			
* C204	1-112-716-11	CERAMIC CHIP 0.1uF 10% 6.3V	C333	1-164-939-11	CERAMIC CHIP 0.0022uF 10% 50V
C205	1-112-717-91	CERAMIC CHIP 1uF 10% 6.3V	* C336	1-112-716-11	CERAMIC CHIP 0.1uF 10% 6.3V
* C206	1-112-716-11	CERAMIC CHIP 0.1uF 10% 6.3V	C345	1-100-670-11	CERAMIC CHIP 4.7uF 20% 16V
* C208	1-112-716-11	CERAMIC CHIP 0.1uF 10% 6.3V	* C356	1-112-298-91	CERAMIC CHIP 1uF 10% 16V
			C358	1-100-539-91	TANTAL. CHIP 47uF 20% 6.3V
* C209	1-112-716-11	CERAMIC CHIP 0.1uF 10% 6.3V			(W170)
* C211	1-112-716-11	CERAMIC CHIP 0.1uF 10% 6.3V			
* C212	1-112-716-11	CERAMIC CHIP 0.1uF 10% 6.3V	C358	1-114-506-91	TANTAL. CHIP 47uF 20% 6.3V
* C213	1-112-716-11	CERAMIC CHIP 0.1uF 10% 6.3V			(W150)
* C214	1-112-716-11	CERAMIC CHIP 0.1uF 10% 6.3V	C359	1-165-989-11	CERAMIC CHIP 10uF 10% 6.3V
			C364	1-100-567-81	CERAMIC CHIP 0.01uF 10% 25V

Ref. No.	Part No.	Description			
C365	1-100-567-81	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	25V
C366	1-100-567-81	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	25V
C367	1-100-567-81	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	25V
* C368	1-114-582-11	CERAMIC CHIP	0.1uF	10%	16V
C371	1-100-670-11	CERAMIC CHIP	4.7uF	20%	16V
C376	1-112-300-91	CERAMIC CHIP	4.7uF	10%	10V
C381	1-112-717-91	CERAMIC CHIP	1uF	10%	6.3V
* C385	1-112-716-11	CERAMIC CHIP	0.1uF	10%	6.3V
* C386	1-112-746-11	CERAMIC CHIP	4.7uF	10%	6.3V
* C389	1-112-716-11	CERAMIC CHIP	0.1uF	10%	6.3V
C390	1-112-717-91	CERAMIC CHIP	1uF	10%	6.3V
* C394	1-114-582-11	CERAMIC CHIP	0.1uF	10%	16V
C397	1-100-670-11	CERAMIC CHIP	4.7uF	20%	16V
* C398	1-114-582-11	CERAMIC CHIP	0.1uF	10%	16V
* C399	1-114-582-11	CERAMIC CHIP	0.1uF	10%	16V
C401	1-100-663-11	TANTAL. CHIP	22uF	20%	10V
* C403	1-112-716-11	CERAMIC CHIP	0.1uF	10%	6.3V
* C503	1-112-716-11	CERAMIC CHIP	0.1uF	10%	6.3V
C505	1-165-897-11	TANTAL. CHIP	22uF	20%	10V
* C506	1-112-716-11	CERAMIC CHIP	0.1uF	10%	6.3V
* C507	1-112-716-11	CERAMIC CHIP	0.1uF	10%	6.3V
* C508	1-112-716-11	CERAMIC CHIP	0.1uF	10%	6.3V
C509	1-128-632-91	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	6.3V
C510	1-128-628-91	CERAMIC CHIP	0.0022uF	10%	6.3V
C511	1-128-632-91	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	6.3V
* C512	1-112-716-11	CERAMIC CHIP	0.1uF	10%	6.3V
C513	1-128-632-91	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	6.3V
C514	1-128-628-91	CERAMIC CHIP	0.0022uF	10%	6.3V
C516	1-128-632-91	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	6.3V
* C517	1-112-716-11	CERAMIC CHIP	0.1uF	10%	6.3V
* C522	1-112-716-11	CERAMIC CHIP	0.1uF	10%	6.3V
* C523	1-112-716-11	CERAMIC CHIP	0.1uF	10%	6.3V
C527	1-165-989-11	CERAMIC CHIP	10uF	10%	6.3V
C528	1-165-989-11	CERAMIC CHIP	10uF	10%	6.3V
C530	1-119-923-11	CERAMIC CHIP	0.047uF	10%	10V
C531	1-119-923-11	CERAMIC CHIP	0.047uF	10%	10V
C532	1-119-923-11	CERAMIC CHIP	0.047uF	10%	10V
C533	1-119-923-11	CERAMIC CHIP	0.047uF	10%	10V
* C534	1-112-716-11	CERAMIC CHIP	0.1uF	10%	6.3V
* C535	1-112-716-11	CERAMIC CHIP	0.1uF	10%	6.3V
* C536	1-112-716-11	CERAMIC CHIP	0.1uF	10%	6.3V
* C537	1-112-716-11	CERAMIC CHIP	0.1uF	10%	6.3V
C547	1-165-989-11	CERAMIC CHIP	10uF	10%	6.3V
* C552	1-112-716-11	CERAMIC CHIP	0.1uF	10%	6.3V
* C553	1-112-716-11	CERAMIC CHIP	0.1uF	10%	6.3V
* C555	1-112-746-11	CERAMIC CHIP	4.7uF	10%	6.3V
* C556	1-112-746-11	CERAMIC CHIP	4.7uF	10%	6.3V
C558	1-125-891-11	CERAMIC CHIP	0.47uF	10%	10V
C559	1-114-411-21	CERAMIC CHIP	0.33uF	10%	6.3V
C560	1-114-411-21	CERAMIC CHIP	0.33uF	10%	6.3V
C603	1-112-815-91	CERAMIC CHIP	10uF	20%	6.3V
C604	1-165-908-11	CERAMIC CHIP	1uF	10%	10V
C605	1-165-908-11	CERAMIC CHIP	1uF	10%	10V
C606	1-125-777-11	CERAMIC CHIP	0.1uF	10%	10V
C607	1-165-908-11	CERAMIC CHIP	1uF	10%	10V
C608	1-165-908-11	CERAMIC CHIP	1uF	10%	10V
C609	1-112-717-91	CERAMIC CHIP	1uF	10%	6.3V

Ref. No.	Part No.	Description			
C610	1-107-819-11	CERAMIC CHIP	0.022uF	10%	16V
C611	1-107-826-11	CERAMIC CHIP	0.1uF	10%	16V
C612	1-100-567-81	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	25V
C613	1-100-567-81	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	25V
C614	1-100-567-81	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	25V
C615	1-100-567-81	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	25V
C616	1-165-989-11	CERAMIC CHIP	10uF	10%	6.3V
C617	1-100-415-91	CERAMIC CHIP	0.47uF	10%	6.3V
C618	1-112-815-91	CERAMIC CHIP	10uF	20%	6.3V
C619	1-100-415-91	CERAMIC CHIP	0.47uF	10%	6.3V
C620	1-100-415-91	CERAMIC CHIP	0.47uF	10%	6.3V
* C701	1-112-716-11	CERAMIC CHIP	0.1uF	10%	6.3V
* C703	1-112-716-11	CERAMIC CHIP	0.1uF	10%	6.3V
* C705	1-112-716-11	CERAMIC CHIP	0.1uF	10%	6.3V
* C706	1-112-746-11	CERAMIC CHIP	4.7uF	10%	6.3V
C708	1-112-021-91	CERAMIC CHIP	2.2uF	20%	16V
C709	1-112-021-91	CERAMIC CHIP	2.2uF	20%	16V
C710	1-112-021-91	CERAMIC CHIP	2.2uF	20%	16V
C711	1-112-021-91	CERAMIC CHIP	2.2uF	20%	16V
C712	1-112-021-91	CERAMIC CHIP	2.2uF	20%	16V
C713	1-112-021-91	CERAMIC CHIP	2.2uF	20%	16V
C714	1-112-021-91	CERAMIC CHIP	2.2uF	20%	16V
C715	1-112-021-91	CERAMIC CHIP	2.2uF	20%	16V
C716	1-114-219-21	CERAMIC CHIP	1uF	10%	10V
C717	1-114-219-21	CERAMIC CHIP	1uF	10%	10V
C718	1-114-219-21	CERAMIC CHIP	1uF	10%	10V
C719	1-114-219-21	CERAMIC CHIP	1uF	10%	10V
C720	1-114-219-21	CERAMIC CHIP	1uF	10%	10V
< CONNECTOR >					
* CN301	1-821-500-11	CONNECTOR, FPC (ZIF) 45P			
* CN401	1-821-501-11	CONNECTOR, FPC (ZIF) 51P			
CN701	1-817-391-52	CONNECTOR, FPC (ZIF) 31P			
* CN702	1-820-634-51	CONNECTOR, FPC (LIF (NON-ZIF))			
* CN703	1-819-990-21	MEMORY STICK DUO CONNECTOR 10P			
* CN704	1-821-503-11	CONNECTOR, FPC (ZIF) 39P			
* CN705	1-821-500-11	CONNECTOR, FPC (ZIF) 45P			
< DIODE >					
D001	6-500-813-01	DIODE MA2SD32008S0			
D002	6-500-813-01	DIODE MA2SD32008S0			
* D003	6-501-961-01	DIODE MAZS120G08S0			
D004	6-500-813-01	DIODE MA2SD32008S0			
* D006	6-502-136-01	DIODE MA2ZD020GLS0			
D007	6-500-813-01	DIODE MA2SD32008S0			
D008	6-500-813-01	DIODE MA2SD32008S0			
D009	6-500-813-01	DIODE MA2SD32008S0			
* D201	6-501-105-01	DIODE DF2S5.6CT (TL3SONY)			
D301	8-719-069-28	DIODE 1SS400TE-61			
D601	8-719-069-28	DIODE 1SS400TE-61			
D701	6-500-813-01	DIODE MA2SD32008S0			
* D702	6-502-310-01	DIODE LNJ826W830S0 (ACCESS)			
< FUSE >					
△ F001	1-576-843-21	FUSE (0.8A/32V)			
△ F002	1-576-415-21	FUSE (2A/32V)			
△ F003	1-576-570-11	FUSE (0.63A/32V)			

• Refer to page 5-1 for mark △.

Ref. No.	Part No.	Description	Ref. No.	Part No.	Description			
< FERRITE BEAD >			R004	1-218-985-11	RES-CHIP	470K	5%	1/16W
FB282	1-469-082-21	INDUCTOR, FERRITE BEAD (1005)	R005	1-240-691-91	METAL CHIP	470	5%	1/20W
FB283	1-469-082-21	INDUCTOR, FERRITE BEAD (1005)	R006	1-240-678-91	METAL CHIP	33	5%	1/20W
FB302	1-400-331-11	FERRITE, EMI (SMD) (1005)	R008	1-240-703-91	METAL CHIP	4.7K	5%	1/20W
FB303	1-400-331-11	FERRITE, EMI (SMD) (1005)	R009	1-240-713-91	METAL CHIP	33K	5%	1/20W
FB309	1-400-331-11	FERRITE, EMI (SMD) (1005)	R013	1-240-729-91	METAL CHIP	1M	5%	1/20W
FB310	1-400-331-11	FERRITE, EMI (SMD) (1005)	R015	1-240-724-91	METAL CHIP	330K	5%	1/20W
FB701	1-400-331-11	FERRITE, EMI (SMD) (1005)	R016	1-245-604-11	METAL CHIP	10M	5%	1/16W
< IC >			R024	1-240-729-91	METAL CHIP	1M	5%	1/20W
* IC001	6-711-572-01	IC SC901572VOR2	R025	1-240-714-91	METAL CHIP	47K	5%	1/20W
* IC201	6-807-572-01	IC uPD79F0043FC-402-2N1-E2-A	R029	1-208-635-11	METAL CHIP	10	0.5%	1/16W
* IC202	6-710-919-01	IC ICS620AN-29LFT (W170)	R032	1-240-695-91	METAL CHIP	1K	5%	1/20W
* IC202	6-711-798-01	IC AK8150BU-L (W150)	R035	1-240-707-91	METAL CHIP	10K	5%	1/20W
IC203	(Not supplied)	IC PRX515103B (IC203 is supplied including in SY-194 complete board.)	R040	1-208-935-11	METAL CHIP	100K	0.5%	1/16W
* IC304	6-710-767-01	IC AD80148BBCZRL	R072	1-218-981-91	RES-CHIP	220K	5%	1/16W
* IC306	6-710-462-01	IC R1114Q231D-TR-FA	R073	1-218-939-11	RES-CHIP	68	5%	1/16W
* IC309	8-753-294-89	IC CXA3741AUR-T9	R205	1-218-931-11	RES-CHIP	15	5%	1/16W
IC401	6-708-033-01	IC M63067WG-DFOT	R207	1-218-935-11	RES-CHIP	33	5%	1/16W (W170)
* IC503	6-709-026-01	IC R2J30500LG	R207	1-218-990-81	SHORT CHIP	0 (W150)		
* IC506	8-753-284-38	IC CXA3739AER-T2	R210	1-218-935-11	RES-CHIP	33	5%	1/16W (W170)
* IC507	6-710-813-01	IC TK63728AB1G0B	R210	1-218-990-81	SHORT CHIP	0 (W150)		
* IC601	6-712-173-01	IC RP103K281D	R212	1-240-808-11	METAL CHIP	10K	0.5%	1/20W
IC602	6-707-834-01	IC BH76812FVM-STR	R213	1-240-695-91	METAL CHIP	1K	5%	1/20W
IC603	6-707-336-01	IC BH6414GLU-SE2	R214	1-240-695-91	METAL CHIP	1K	5%	1/20W
< COIL >			R215	1-218-941-11	RES-CHIP	100	5%	1/16W
* L001	1-457-566-11	INDUCTOR 4.3uH	R216	1-220-180-11	RES-CHIP	620	5%	1/16W
* L002	1-457-512-21	INDUCTOR 10uH	R217	1-240-683-91	METAL CHIP	100	5%	1/20W
L003	1-457-066-21	INDUCTOR 4.7uH	R218	1-240-685-91	METAL CHIP	150	5%	1/20W
* L004	1-457-512-21	INDUCTOR 10uH	R219	1-240-685-91	METAL CHIP	150	5%	1/20W
* L005	1-457-512-21	INDUCTOR 10uH	R220	1-240-685-91	METAL CHIP	150	5%	1/20W
L006	1-400-676-11	INDUCTOR 22uH	R221	1-240-685-91	METAL CHIP	150	5%	1/20W
* L008	1-457-512-21	INDUCTOR 10uH	R222	1-240-685-91	METAL CHIP	150	5%	1/20W
* L009	1-457-512-21	INDUCTOR 10uH	R227	1-240-695-91	METAL CHIP	1K	5%	1/20W
* L241	1-481-102-21	INDUCTOR 10uH	R231	1-240-695-91	METAL CHIP	1K	5%	1/20W
* L302	1-481-102-21	INDUCTOR 10uH	R233	1-469-580-21	INDUCTOR, FERRITE BEAD (1005) (Note)			
* L303	1-481-102-21	INDUCTOR 10uH	R234	1-469-580-21	INDUCTOR, FERRITE BEAD (1005) (Note)			
L701	1-400-588-11	INDUCTOR 10uH	R235	1-469-580-21	INDUCTOR, FERRITE BEAD (1005) (Note)			
< TRANSISTOR >			R236	1-469-580-21	INDUCTOR, FERRITE BEAD (1005) (Note)			
Q001	6-551-346-01	TRANSISTOR LSK3541FS8T2L	R237	1-469-580-21	INDUCTOR, FERRITE BEAD (1005) (Note)			
Q002	6-550-844-01	TRANSISTOR FDW2508P/GNL	R238	1-240-707-91	METAL CHIP	10K	5%	1/20W
Q003	8-729-055-89	TRANSISTOR MCH3306-TL-E-S	R241	1-694-535-91	SHORT CHIP	0		
Q004	6-551-202-01	TRANSISTOR LM6K1FS8T2R	R247	1-218-990-81	SHORT CHIP	0		
* Q301	6-551-868-01	TRANSISTOR UP04213G08S0	R251	1-240-707-91	METAL CHIP	10K	5%	1/20W
Q302	6-550-119-01	TRANSISTOR DTC144EMFS6T2L	R252	1-240-707-91	METAL CHIP	10K	5%	1/20W
Q303	6-550-791-01	TRANSISTOR SSM3J15FV (TL3SONYZ)	R253	1-218-933-11	RES-CHIP	22	5%	1/16W
Q305	6-551-202-01	TRANSISTOR LM6K1FS8T2R	R254	1-218-933-11	RES-CHIP	22	5%	1/16W
* Q401	6-551-224-01	TRANSISTOR RN2110ACT (TL3SONY)	R260	1-240-766-11	METAL CHIP	180	0.5%	1/20W
Q701	6-550-119-01	TRANSISTOR DTC144EMFS6T2L	R261	1-208-663-11	METAL CHIP	150	0.5%	1/16W
* Q702	6-551-980-01	TRANSISTOR SSM3J120TU (T5LSONY)	R262	1-208-663-11	METAL CHIP	150	0.5%	1/16W
< RESISTOR >			R263	1-208-691-11	METAL CHIP	2.2K	0.5%	1/16W
R001	1-240-726-91	METAL CHIP 470K 5% 1/20W	R266	1-208-691-11	METAL CHIP	2.2K	0.5%	1/16W
R002	1-240-729-91	METAL CHIP 1M 5% 1/20W	R267	1-240-824-91	METAL CHIP	56K	0.5%	1/20W
			R268	1-240-824-91	METAL CHIP	56K	0.5%	1/20W
			* R269	1-240-797-91	METAL CHIP	3.6K	0.5%	1/20W
			R270	1-240-784-91	METAL CHIP	1K	0.5%	1/20W
			R271	1-240-784-91	METAL CHIP	1K	0.5%	1/20W

Note: Ferrite bead are mounted to the location where R233 to R237 are printed.

Note: R233～R237にはフェライトビーズがマウントされています。

Ref. No.	Part No.	Description				Ref. No.	Part No.	Description			
R272	1-240-707-91	METAL CHIP	10K	5%	1/20W	* R506	1-240-790-91	METAL CHIP	1.8K	0.5%	1/20W
R273	1-240-830-11	METAL CHIP	100K	0.5%	1/20W	R507	1-240-808-11	METAL CHIP	10K	0.5%	1/20W
R274	1-240-830-11	METAL CHIP	100K	0.5%	1/20W	* R509	1-245-671-11	METAL CHIP	39K	0.5%	1/20W
R276	1-240-822-11	METAL CHIP	47K	0.5%	1/20W	R511	1-240-695-91	METAL CHIP	1K	5%	1/20W
R289	1-208-943-11	METAL CHIP	220K	0.5%	1/16W	R512	1-240-808-11	METAL CHIP	10K	0.5%	1/20W
R294	1-208-943-11	METAL CHIP	220K	0.5%	1/16W	R513	1-240-806-11	METAL CHIP	8.2K	0.5%	1/20W
R297	1-240-718-91	METAL CHIP	100K	5%	1/20W	R514	1-208-893-11	METAL CHIP	1.8K	0.5%	1/16W
R301	1-240-729-91	METAL CHIP	1M	5%	1/20W	R515	1-240-808-11	METAL CHIP	10K	0.5%	1/20W
R302	1-240-718-91	METAL CHIP	100K	5%	1/20W	R516	1-240-718-91	METAL CHIP	100K	5%	1/20W
R303	1-208-637-11	METAL CHIP	12	0.5%	1/16W	R517	1-240-718-91	METAL CHIP	100K	5%	1/20W
R304	1-220-802-11	RES-CHIP	3.3	5%	1/16W	R518	1-218-977-11	RES-CHIP	100K	5%	1/16W
R305	1-220-802-11	RES-CHIP	3.3	5%	1/16W	R519	1-218-977-11	RES-CHIP	100K	5%	1/16W
R306	1-220-802-11	RES-CHIP	3.3	5%	1/16W	R520	1-218-977-11	RES-CHIP	100K	5%	1/16W
R316	1-218-933-11	RES-CHIP	22	5%	1/16W	R521	1-218-977-11	RES-CHIP	100K	5%	1/16W
R323	1-218-978-11	RES-CHIP	120K	5%	1/16W	R522	1-218-977-11	RES-CHIP	100K	5%	1/16W
R324	1-240-695-91	METAL CHIP	1K	5%	1/20W	R523	1-240-695-91	METAL CHIP	1K	5%	1/20W
R325	1-240-695-91	METAL CHIP	1K	5%	1/20W	R527	1-218-989-11	RES-CHIP	1M	5%	1/16W
R327	1-240-695-91	METAL CHIP	1K	5%	1/20W	R528	1-218-989-11	RES-CHIP	1M	5%	1/16W
R336	1-218-984-11	RES-CHIP	390K	5%	1/16W	R529	1-208-911-11	METAL CHIP	10K	0.5%	1/16W
R337	1-218-970-11	RES-CHIP	27K	5%	1/16W (W150)	R534	1-208-911-11	METAL CHIP	10K	0.5%	1/16W
R337	1-220-199-81	RES-CHIP	24K	5%	1/16W (W170)	R537	1-240-711-91	METAL CHIP	22K	5%	1/20W
R338	1-218-941-81	RES-CHIP	100	5%	1/16W	R538	1-240-711-91	METAL CHIP	22K	5%	1/20W
R339	1-218-977-11	RES-CHIP	100K	5%	1/16W	R539	1-240-711-91	METAL CHIP	22K	5%	1/20W
R359	1-218-983-11	RES-CHIP	330K	5%	1/16W	R540	1-240-711-91	METAL CHIP	22K	5%	1/20W
R360	1-240-687-91	METAL CHIP	220	5%	1/20W	R543	1-694-535-91	SHORT CHIP	0		
R361	1-240-722-91	METAL CHIP	220K	5%	1/20W	R547	1-208-711-11	METAL CHIP	15K	0.5%	1/16W
R362	1-218-983-11	RES-CHIP	330K	5%	1/16W	R548	1-208-711-11	METAL CHIP	15K	0.5%	1/16W
R363	1-218-976-11	RES-CHIP	82K	5%	1/16W (W150)	R601	1-218-929-11	RES-CHIP	10	5%	1/16W
R363	1-218-978-11	RES-CHIP	120K	5%	1/16W (W170)	R603	1-216-807-11	METAL CHIP	68	5%	1/10W
R364	1-218-979-11	RES-CHIP	150K	5%	1/16W	R604	1-240-693-91	METAL CHIP	680	5%	1/20W
R382	1-240-678-91	METAL CHIP	33	5%	1/20W	R605	1-240-726-91	METAL CHIP	470K	5%	1/20W
R383	1-240-678-91	METAL CHIP	33	5%	1/20W	R607	1-240-697-91	METAL CHIP	1.5K	5%	1/20W
R384	1-240-678-91	METAL CHIP	33	5%	1/20W	R608	1-240-701-91	METAL CHIP	3.3K	5%	1/20W
R385	1-240-678-91	METAL CHIP	33	5%	1/20W	R611	1-240-708-91	METAL CHIP	12K	5%	1/20W
R386	1-240-678-91	METAL CHIP	33	5%	1/20W	R701	1-240-687-91	METAL CHIP	220	5%	1/20W
R387	1-240-678-91	METAL CHIP	33	5%	1/20W (W170)	R702	1-240-718-91	METAL CHIP	100K	5%	1/20W
R387	1-694-535-91	SHORT CHIP	0 (W150)			R704	1-240-808-11	METAL CHIP	10K	0.5%	1/20W
R391	1-245-265-11	METAL CHIP	8.2	5%	1/16W	R707	1-240-695-91	METAL CHIP	1K	5%	1/20W
R401	1-240-690-91	METAL CHIP	390	5%	1/20W	R726	1-240-715-91	METAL CHIP	56K	5%	1/20W
R402	1-240-689-91	METAL CHIP	330	5%	1/20W	R801	1-240-695-91	METAL CHIP	1K	5%	1/20W
R405	1-208-635-11	METAL CHIP	10	0.5%	1/16W	< SENSOR >					
R407	1-240-789-91	METAL CHIP	1.6K	0.5%	1/20W	* SE501	1-479-022-61	SENSOR, ANGULAR VELOCITY (YAW)			
R408	1-240-805-91	METAL CHIP	7.5K	0.5%	1/20W	* SE502	1-479-022-51	SENSOR, ANGULAR VELOCITY (PITCH)			
R411	1-240-690-91	METAL CHIP	390	5%	1/20W	< VARISTOR >					
R412	1-240-690-91	METAL CHIP	390	5%	1/20W	* VDR002	1-802-279-11	VARISTOR (SMD)			
R418	1-240-714-91	METAL CHIP	47K	5%	1/20W	< VIBRATOR >					
R419	1-208-635-11	METAL CHIP	10	0.5%	1/16W	X001	1-781-525-11	VIBRATOR, CRYSTAL (32.768kHz)			
R420	1-208-635-11	METAL CHIP	10	0.5%	1/16W	* X201	1-813-860-21	OSCILLATOR, CRYSTAL (36MHz) (W150)			
* R502	1-245-671-11	METAL CHIP	39K	0.5%	1/20W	* X201	1-813-904-21	QUARTZ CRYSTAL OSCILLATOR (38MHz) (W170)			
R503	1-240-678-91	METAL CHIP	33	5%	1/20W						
R504	1-240-808-11	METAL CHIP	10K	0.5%	1/20W						
R505	1-240-806-11	METAL CHIP	8.2K	0.5%	1/20W						

*: S.M. revised only top cover.

DSC-W150/W170_L3